公開実用平成 2-131301

⑬ 日 本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出題公開

☞ 公開実用新案公報(U) 平2-131301

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月31日

H 01 C 7/10

7048-5E 7303-5E Z

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称 パリスタ

> ②実 頭 平1-39825

頤 平1(1989)4月4日 20出

②考案 者 佐 苺 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

⑩出 願 人 テイーディーケイ株式 東京都中央区日本橋 1 丁目13番 1号

会社

⑫代 理 人 弁理士 阿部 美次郎 明 細 書

()

1. 考案の名称

バリスタ

2. 実用新案登録請求の範囲

バリスタ素子と、電極端子と、絶縁外装体と有 するバリスタであって、

前記バリスタ素子は、板状であるバリスタ素体の厚み方向の両面に電極を有しており、

前記電極端子は、少なくとも一対備えられており、前記電極端子のそれぞれは、金属板で構成されていて、前記バリスタ素子の前記電極のそれぞれに重ねられて面接触する接触片と、前記接触片に連続する端子片とを有しており、

前記絶縁外装体は、前記バリスタ素子及び前記電極端子の前記接触片を覆っており、

前記電極端子の前記端子片は、前記絶縁外装体の外部に導出されていること

を特徴とするバリスタ。

3 . 考案の詳細な説明

<産業上の利用分野>

1



○公開実用平成○2-131301

本考案は、バリスタに関し、バリスタ素体の両面に電極を有するバリスタ素子の電極に、金属板でなる電極端子を面接触させ、電極端子の端子片を絶縁外数体の外部に導出することをよって、ジッケージ・タイプ(以ファル・イン・ライン・パッケージ・タイプ(以ファル・イン・カイン・がある)や、面付け実装タイプとして使用できるようにしたものである。

<従来の技術>

第5図は従来のバリスタの正面部分断面図、 第6図は同じく側面部分断面図を示し、円板状等 の適当な形状に形成されたバリスタ素体1の両 面に電極2、3を形成し、電極2、3にリード線 4、5を接続した上で、全体を絶縁樹脂による絶 緑外装体6で覆った構造となっている。

第7図は別の従来例を示し、バリスタ素体1の 相対する両端部に、電極2、3のそれぞれに各別 に導通する端部電極7、8を付与し、電極2、3 の表面を絶縁樹脂9、10によって被覆したチッ ブ・タイプとなっている。 <考案が解決しようとする課題>

第7回の従来例の場合は、面実装が可能で、高さが低くなる利点は得られるが、熱容量が小さいため、エネルギー耐量が低いという問題点がある。

そこで、本考案の課題は、上述する従来の問題点を解決し、DIPタイプや面付け実装タイプとして使用でき、しかもエネルギー耐量の大きなバリスタを提供することである。

◇開実用平成 2─131301

<課題を解決するための手段>

上述する課題を解決するため、本考案は、バリスタ素子と、電極端子と、絶縁外装体と有するバリスタであって、

前記バリスタ素子は、板状であるバリスタ素体の厚み方向の両面に電極を有しており、

前記電極端子は、少なくとも一対備えられており、前記電極端子のそれぞれは、金属板で構成されていて、前記バリスタ素子の前記電極のそれぞれに重ねられて面接触する接触片と、前記接触片に連続する端子片とを有しており、

前記絶縁外装体は、前記バリスタ素子及び前記電極端子の前記接触片を覆っており、

前記電極端子の前記端子片は、前記絶縁外装体の外部に導出されていることを特徴とする。

く作用>

バリスタ素子は、板状であるバリスタ素体の厚み方向の両面に電極を有しており、電極端子のそれぞれは、金属板で構成されていて、バリスタ素

子の電極のそれぞれに重ねられて面接触する接触 片と、接触片に連続する端子片とを有しているの で、熱容量を大きくとることができる。このた め、エネルギー耐量が大きくなる。

絶縁外装体は、バリスタ素子及び電極端子の接触片を覆っており、電極端子の端子片は、絶縁外装体の外部に導出されているので、DIPタイプや面付け実装タイプとして使用でき、回路基板上で、他のDIPタイプ電子部品、汎用ICもしくはチップ部品と共存させるのに適したバリスタが得られる。

<実施例>

第1図は本考案に係るバリスタの分解斜視図で、絶縁外装体を省略して示す図、第2図は同じくその断面図である。図において、16はバリスタ素子、17及び18は電極端子、19は絶縁外装体である。

バリスタ素子16は、矩形板状等の適当な形状に形成されたバリスタ素体161の厚み方向の両面に、電極162、163を有している。

◎公開実用平成②─131301

絶縁外装体19は、例えばエポキシ樹脂等の絶縁樹脂でなり、バリスタ素子16及び電極端子17、18の接触片171、181の全体を覆っている。

電極端子17、18の端子片172、182は、絶縁外装体19の側端面から外部に導出さ

れ、厚み方向に沿うように折曲げられている。これにより、他のDIPタイプ電子部品や汎用ICと同様の構成になるバリスタが得られる。

第3回は回路基板11に対する実装状態を示す図で、端子片172、182を、回路基板11 に設けられた孔111、112内に挿入すると 共に、回路基板11に設けられた導体パターン 12、13に半田14、15によって固着してある。

第4図は本考案に係るバリスタの別の実施例を示す断面図である。この実施例は、面付け実装タイプのバリスタを示し、端子片172、182は、絶縁外装体19の厚み方向の一面に沿って平面的に配置されている。

く考案の効果>

以上述べたように、本考案によれば、次のような効果が得られる。

(a) バリスタ素子は、板状であるバリスタ素体の厚み方向の両面に電極を有しており、電極端子のそれぞれは、金属板で構成されていて、バリス

分開実用平成 2-131301

タ素子の電極のそれぞれに重ねられて面接触する 接触片と、接触片に連続する端子片とを有してい るから、熱容量が大で、エネルギー耐量の大きな バリスタを提供できる。

(b) 絶縁外装体は、バリスタ素子及び電極端子の接触片を覆っており、電極端子の端子片は、絶縁外装体の外部に導出されているので、他のDIPタイプ電子部品、汎用ICもしくはチップ部品と共存させるのに適したバリスタを提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係るバリスタの分解斜視図で、絶縁外装体を省略して示す図、第2図は同じくその断面図、第3図は本考案に係るバリスタの実践がある。第4図は本考案に係るバリスタの別の実施例を示す断面図、第5図は従来のバリスタの正面部分断面図、第6図は同じく側面部分断面図、第7図は別の従来例における断面図、第8図は第5図及び第6図に示した従来のバリスタの問題点を示す図である。

16・・・バリスタ素子

161・・・バリスタ素体

162、163・・・電極

17、18・・・電極端子

171、181・・・接触片

172、182・・・端子片

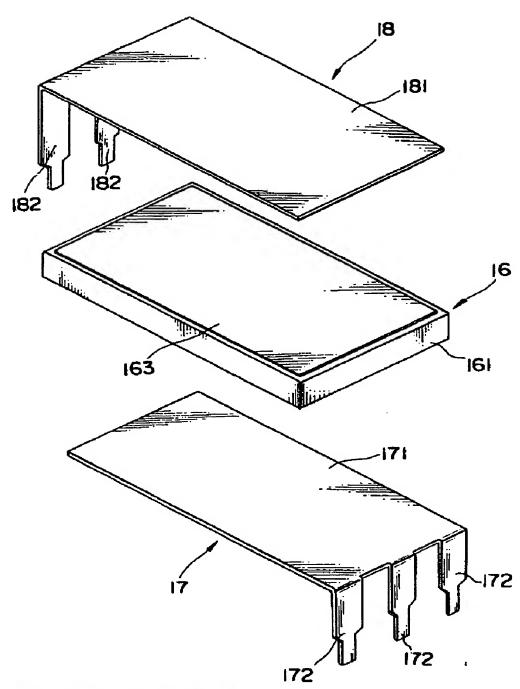
19・・・絶縁外装体

実用新案登録出願人 ティーディーケイ株式会社

代理人 弁理士 阿 郎 美 次 郎

公開実用平成 2-1313 1

第 1 図



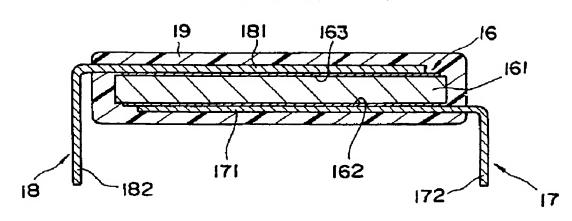
上级出版人

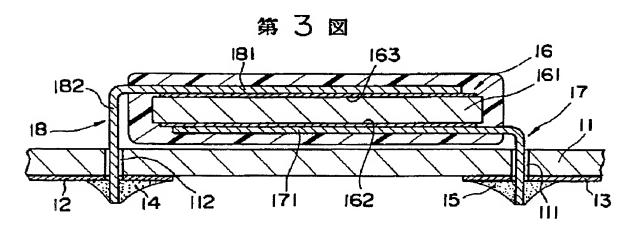
ディーディーケイ株式会社

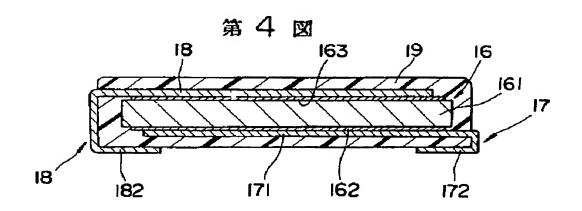
代理人 弁理士 阿部美灰郎

10

第 2 図







実用新案登録出顧人

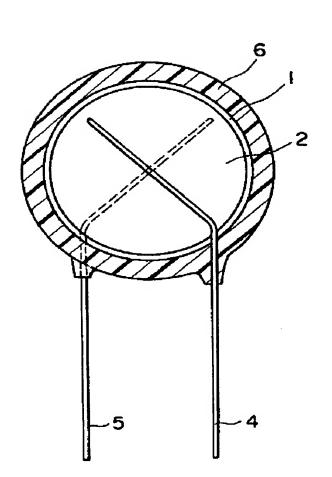
ティーディーケイ株式会社

代理人 弁理士 阿部美衣郎

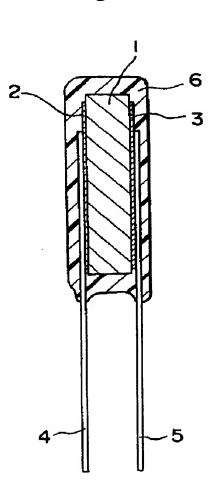
11

公開実用平成 2-101301

第5図



第6図



実用新案登録出顧人

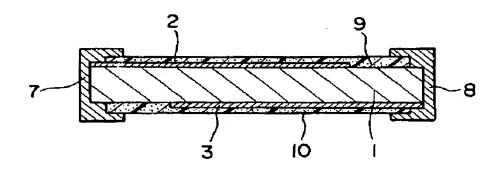
ティーディーケイ株式会社

代理人 弁理士 阿部美衣郎

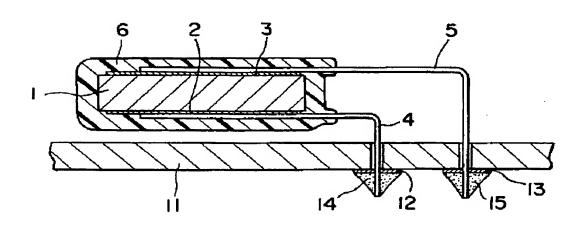
12

実問 2 -13130

第7図



第8図



実用新案登録出顧人

サイーディーケイ株式会社

代理人 弁理士 阿部美次郎

13

実問 2 -131301